# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-305915

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G03F 7/20

(21)Application number: 03-094867

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

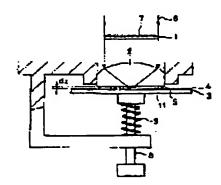
MATSUBARA TAKASHI

## (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To make thin the film thickness of an immersion liquid interposed between a photo-mask or an optical projection system and a wafer and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on an exposure lens 2 through an immersion liquid 5. A surface-active agent 11 is mixed into the immersion liquid 5 within a range that the photoresist 4 is not affected, and the surface-active agent 11 reduces the surface tension of the immersion liquid 5, and improves wettability. Accordingly, the film thickness d2 of the immersion liquid is made thinner than the case where surface-active agent is not mixed.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公别各母

### 特開平4-305915

(43)公顷日 平成4年(1992)10月28日

(51)IntCL1	<b>森別配号</b>	庁内登项部号	F 1	技術表示留所
H01L 21/0 G03F 7/2		7818—2H 7352—4M	H01L 21/30	311 A
•			安全 水田 水田 東京	高泉項の数1(全 3 頁)
(21) 出題參号	特頭平3-94867		(71)出題人 000004112	

株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 (72)発明者 大岡 尚夫 東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式 会社ニコン大井銀作所内 (72)発明者 松原 隆 東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式 会社ニコン大井銀作所内 (74)代理人 分理士 山川 政樹

#### (54) [発明の名称] 密岩数質光鉄器

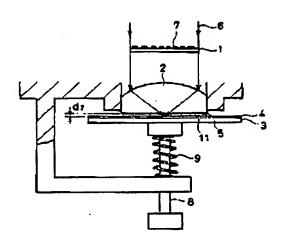
### (57) 【要約】

(22)出題日

(目的) 密報型電光換管において、フォトマスクまた は投影光学系とウエハとの間に介在される投資の模學を 降くして光の吸収量を少なくし、解光ムラを経対防止す ることを目的とする。

平成3年(1991)4月2日

【構成】 フォトレジスト4を独布されたウエハ3を露 光レンズ2に良被5を介して哲智させる。 役款6にはフォトレジスト4に影響を与えない範囲で界面活性剤11 が混入されており、界面活性剤11は、提散5の表面温 力を減らし、描れ性を高める。したがって、段波の旗厚 dx は界面活性剤を混入しない場合より得くなる。



(2)

#### [特許請求の範囲]

【開求項1】 フォトレジストを無布されたウエハを投 形式学系もしくはフォトマスクに侵滅を介して審着を せ、限耐光の原射によりフォトマスクのバターンを前配 フォトレジストに転写するようにした密想回動光設置に おいて、前配役施は前配フォトレジストに影響を与えな い範囲で非国語性剤が認入されていることを特徴とする 依容質像光接度。

#### [発明の浄脈な説明]

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程において、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影部光 する角光装置、特に密着型角光装置に関するものである。

#### [0002]

【使来の技術】レーザー光等を展別しフォトマスク上のパターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導体基板上に投影場光するこの器の電光業優における扇光方式としては、①密着(コンタクト)電光方式、②プロキシミティ解光方式、③反射型投影解光方式、④縮小レンズ投影優光方式の4方式が知られている。

【6603】このうち密考露光方式は、フォトマスク(全たは投影光学系)とウエハとを密着させて展光するもので、これらが完全に密着している場合には、フォトレジスト中の放長が風折串分の1に短くなるため、四折の影響が少なく、高解像度の転率が得られるという特色を有している。この協議は真空受着、静電チャック等によって行っている。しかし、完全な密考を実現することは極めて難しく、またフォトマスクとウエハとを接触的に接触させているためにウエハ表面の突起等によりフォルマスクに欠陥が左じ、その寿命を低下させると同時にデバイスの非知りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、密密解光方式によるこのような問 超を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に被体 (投設) を充填している。四2はウエハを投設を介して 投影光学系に密岩させた場合を示すもので、1はフォト マスク、2は投影光学系の一部を構成する輝光レンズ、 3はフォトレジスト4が塗布されたウエハ、5は電光レ ンズ2とウエハ3間に完集された投稿、6はフォトマス ク1のパターン?を照射しフォトレジスト4を開光する 版射光、8はウエハ3を保持する保持体、9は保持体8 を上方に付替しウエハ3を開光レンズ2に所定圧にて押 し付ける圧縮コイルばねである。 風射光6の被長は短い ほど回折の影響が少なく、そのため光度としてエキシマ レーザー等のレーザー装置が用いられる。 没破 5 として は、屈折率がフォトレジスト4と両程度で光の吸収が少 なく、しかもフォトレジスト4を密かさないものが望ま しく、遺物和水が使用される。

[0005]

【契明が無決しようとする謎題】しかしながら、上述したような投液5を使用した患者型電光装置においては、 起鉄5自身の関原ムラがあると、投資5による限制光6の吸収量にムラが生じるため、コンタクト電光されたフォトレジスト4のパターンが的確に臨光されている部分とそうでない部分とが生じてしまうという問題があった。したがって、このような電光ムラの発生を防止するため、投散5の機れ性を高めて衰困張力を下げ、原厚は、老板力等くすることが温まれている。

10 [0006]本発明は上述したような従来の問題点および受望に無みてなされたもので、その目的とするところは、没数の環界を算くし、没数による質光ムラを軽減防止し得るようにした都希型観光設置を提供することにある。

#### [0007]

【課題を祭決するための学校】本発明は上記目的を達成するため、フォトレジストを塗布されたウエハを投影光学系もしくはフォトマスクに浸液を介して密着させ、展動光の限射によりフォトマスクのパターンを前配フォトレジストに気率するようにした密着型電光装置において、前配浸液は前記フォトレジストに影響を与えない義団で非面積性新が混入されているものである。

#### [0008]

(作用) 本発明において界面を性剤は浸液の強れ性を高め、接面張力を下げる。したがって浸透の膜厚を薄くする。

#### [0009]

【表施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型電光変配の 一実施例を示す要部の新面径である。なお、図中図2と 同一義成部品のものに対しては両一符号を以て示し、そ の説明を容勢する。

【0010】 本実施例は投影光学系にウエハを密着させた場合を示するので、フォトマスク投影光学系の一部を 協成する電光レンズ2とウエハ3との間に介在される軸 水等の侵級5に界面話性別、1を提入したものである。

[0011] 外面衝性刺11としては、関イオン性、陰イオン性、外イオン性等様々のものが使用可能であるが、風折率が受散5と同程度で光の吸収が少なく、またフォトレジスト4を指かしたりすることのない範囲で認入されることが望ましい。特に、筒イオン性のうち四級アンモニウム塩系は、適れ性も高く、レジストへの影響も少なく、光の吸収も少ないため好ましい。

[0012] かくしてこのような構成においては界面符 性別11が侵抜るの表面張力を被らして満れ性を高める ため、ウエハ3を所定圧力にて電光レンズ2に圧接した 際、投液5の膜厚点。を図2に示した健来接置と比較し で薄くする(d)くdi)ことができ、また原写が導く なれば光の吸収量も少なくなるので、これに比例して光 の吸収ムラが減少し、電光ムラモ軽減防止することがで (3)

特別平4-305915

きるものである.

[0013]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る奇容型 概光製度によれば、優級に界面活性剤を加入することに より、提接自身の表面張力を繰らして添れ性を向上させ るようにしたので、侵滅の襲厚を導くすることができ る。したがって、侵液の鎮厚ムラが小さく、光の吸収を 少なくすることができ、漫版による軽光ムラを軽減防止 することができる。

## 【図面の簡単な設制】

【図1】本発明に係る告着型線光数管の一実施例を示す 技術の販面図である。 【図2】 密管型電光接触の従来例を示す妥協の新頭回で

## 【符号の設制】

- 1 フォトマスク
- 2 佐光レンズ
- 3 ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 提胺
- 6 田射光
- 7 マスク
- 11 非課金任用

